

Arnitel[®] EM550

TPC-ET

薄膜挤出, 食品接触级

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
熔体体积流动速率	9	cm³/10min	ISO 1133
温度	230	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
机械性能	数值		
绍氏硬度D (3s)	52	—	ISO 868
拉伸模量	175	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	25	MPa	ISO 527-1/-2
标称断裂应变	360	%	ISO 527-1/-2
5%应变时的应力	8	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	12	MPa	ISO 527-1/-2
50%应变时的应力	15	MPa	ISO 527-1/-2
100%应变时的应力	16	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	N	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	25	kJ/m²	ISO 179/1eA
弯曲模量	180	MPa	ISO 178
70°C时恒定应变下的永久变形	40	%	ISO 815
机械性能 (冲压)	数值		
断裂应力 (垂直)	41	MPa	ISO 527-1/-2
撕裂强度 (垂直)	125	kN/m	ISO 34-1; Method B
撕裂强度 (平行)	134	kN/m	ISO 34-1; Method B
断裂应变 (垂直)	820	%	ISO 527-1/-2

性能

Arnitel[®] EM550

性能	典型资料	单位	测试方法
热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	207	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度(50°C/h 50N)	90	°C	ISO 306
线热膨胀系数(平行)	1.5	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	1.5	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	HB	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
电性能	数值		
相对介电常数(100Hz)	4.4	—	IEC 62631-2-1
相对介电常数(1MHz)	4	—	IEC 62631-2-1
介质损耗因子(1MHz)	400	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	21	kV/mm	IEC 60243-1
其它性能	数值		
密度	1200	kg/m³	ISO 1183
吸水率	0.65	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	0.2	%	Sim. to ISO 62